

关键指标

频率: DC~20GHz
插入损耗: 1dB
隔离度: 40dB
电压/电流: -5V/1mA
控制电平: 0/+3.3V, 0/+5V
芯片尺寸: 1.15 mm×1mm×0.1mm

产品简介

HG126KB 是一款 DC~20GHz 反射式单刀双掷开关芯片, 插入损耗为 1dB, 隔离度为 40dB。集成控制驱动器, -5V 单电源供电。

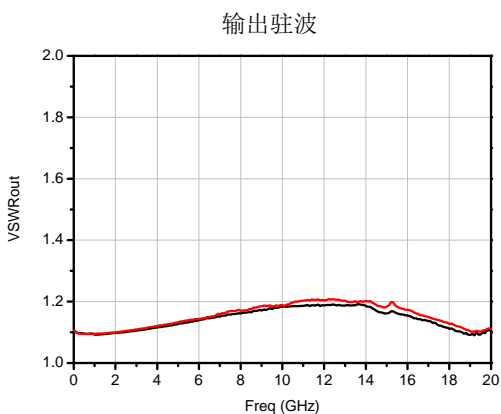
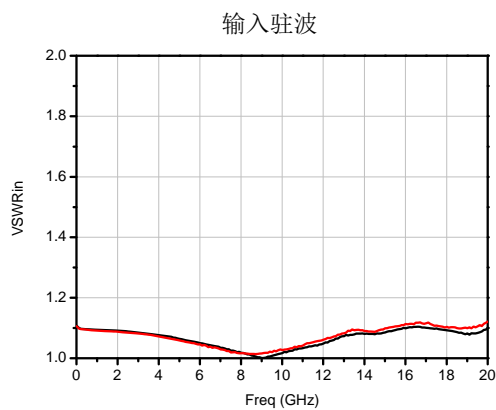
电性能 (TA=25°C, Vdd=-5V)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~20		
插入损耗(dB)	-	1	-
隔离度(dB)	-	40	-
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	1.2	-
静态电流 (mA)	-	1	-

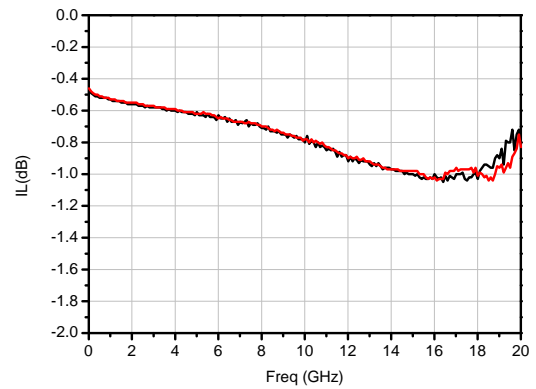
真值表 (0: 0V, 1: 3V~5V)

SW	RFC to RF1	RFC to RF2
0	ON	OFF
1	OFF	ON

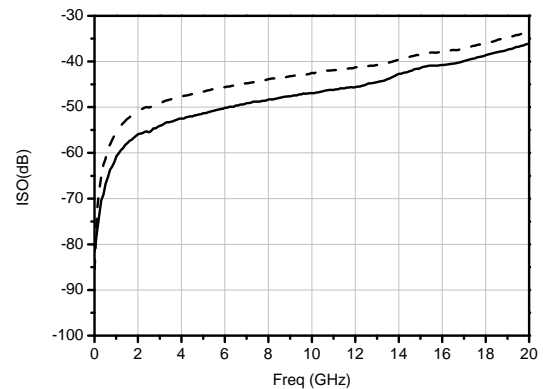
典型测试曲线



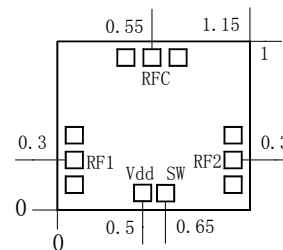
插入损耗



隔离度



外形和端口尺寸 (mm)



绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm	
工作电压	-5.5V	
控制电平	低电平: 0~0.5V	高电平: 3~5V
工作温度	-55°C~125°C	
存储温度	-65°C~150°C	

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400 μm ;
5. 芯片微波端无隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。